

ICS 31.070

团体标准

T/SZBSIA 006-2022

IC类半导体固晶机技术规范

Semiconductor die bonder technical norm

2022-09-23发布

2022-9-24实施

深圳市宝安区半导体行业协会 发布

目录

前 言.....	2
1 范围.....	3
2 规范性引用文件.....	3
3 术语和定义.....	4
4 结构、基本参数及工作条件.....	4
5 技术要求.....	7
5.1 基本要求.....	7
5.2 加工及装配要求.....	8
5.3 整机性能.....	9
6 试验方法.....	12
7 使用说明书、标志、包装、运输和贮存.....	17

前 言

本文件依据GB/T1.1-2020《标准化导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市宝安区半导体行业协会提出并归口。

本文件主要起草单位：深圳新益昌科技股份有限公司、深圳市宝安区半导体行业协会、深圳市洲明科技股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司、深圳雷曼光电科技股份有限公司、深圳市锐骏半导体股份有限公司、深圳市聚飞光电股份有限公司、深圳市秀武电子有限公司、深圳市信展通电子股份有限公司、深圳市宝安区集成电路产业技术创新联盟、深圳市时创意电子有限公司、深圳清华大学研究院、深圳市路远智能装备有限公司、深圳市振华兴科技有限公司、深圳市晶凯电子技术有限公司、深圳绘王趋势科技股份有限公司、深圳市三联盛科技股份有限公司。

本文件主要起草人：彭顺安、刘慧、于江情、郑文杰、曾晓明、王跃飞、余亮、黄泽军、孙平如、赵越、施锦源、马保峰、刘岩、敬刚、贾孝荣、廖怀宝、刘纪文、王周宏、张莹、朱文锋。

本标准是首次发布。